



WORLD BEST PRODUCTS
BEYOND KOREA & BE THE GLOBAL NO.1

TAESUNG

Investor Relations 2022



Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에 정보제공을 목적으로 (주)태성(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려 드리는 바입니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 별도 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며,본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사, 자문역 또는 Representative들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다 (과실 및 기타의 경우 포함). 또한 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

**WORLD BEST PRODUCTS
BEYOND KOREA
& BE THE GLOBAL NO.1**



Contents

Prologue

01. Company Overview

02. Market Sketch

03. Investment Highlights

04. Growth Strategy

Appendix



Prologue

- 01. 高사양 / 高부가 / 초정밀 PCB 수요의 폭발적 증가
- 02. Corporate Identity
- 03. PCB 종류



01 高사양 / 高부가 / 초정밀 PCB 수요의 폭발적 증가

PCB 수요 증가는 단기적인 현상이 아닌 3차 산업의 구조적 진화에 기인



※ PCB(PRINTED CIRCUIT BOARD) : 인쇄회로기판 / CSP(Chip Size Package) / FPCB(FLEXIBLE PCB) / MLB (Multi Layer Board): 다층회로기판 / SLP(Substrate Like PCB) / FC-BGA(Flip Chip-Ball Grid Array)

02 Corporate Identity



국내 PCB 공정 자동화설비 No.1 ⇒ PCB 고사양화의 최대 수혜주

TAESUNG 국내 No.1 PCB 공정 자동화설비 MAKER

PCB 前처리
자동화설비 M/S 1위



글로벌 Big Maker
설비 공급



국내 최초 정면기 국산화 및
"세계일류상품" 선정



표면처리설비 및 식각설비
고도화 기술력 보유

최고의 제품 라인업

주력상품 정면기,
"세계일류상품" 선정

FPCB 핵심공정 설비 등
(D.E.S Line)
프리미엄 PCB 설비 공급

글로벌 Top Tier 고객사 확보

국내외 50여개
PCB Big Maker 고객군 확보

핑딩(폭스콘 자회사),
SCC(중국1위),
Fast Print(세계33위),
삼성전기, LG이노텍 등

해외 생산거점 확보

PCB 최대 생산국인 중국
중심의 생산 및 영업 거점 확보

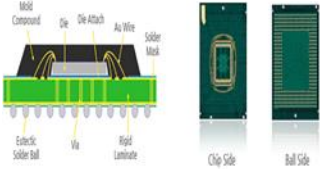
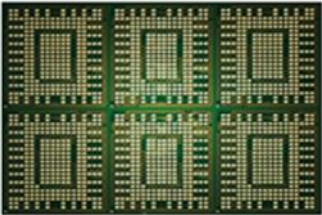
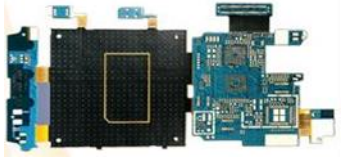
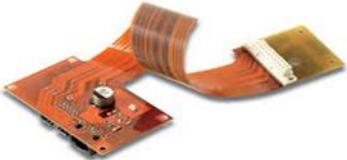
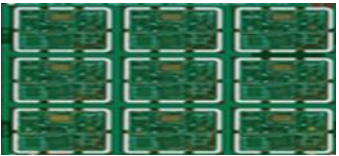
전체 매출의 수출비중 58%
(2021년 기준)

PCB 고사양화에 따른 역할 확대

다양한 제품군과 검증된
기술력 바탕으로,
FPCB, FC-BGA, CSP 등
차세대 프리미엄 PCB
공정설비 개발 / 납품

03 PCB 종류

당사 설비로 생산되는 PCB 종류

PKG (FC-BGA)	PKG (FC-CSP)	RF-PCB
		
AI, 자율주행, 데이터 서버 등 CPU, GPU	모바일기기 (AP)	전자부품 산업에 광범위
삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 코리아씨키트	삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 심텍	비에이치, 영풍전자
FPCB	HDI	MLB
		
디스플레이 제품	5G/6G, 클라우드 컴퓨팅 등	메모리모듈
비에이치, 영풍전자, 인터플렉스	코리아씨키트, 심텍, 이수페타시스	대덕전자, 이수페타시스

1. Company Overview

- 01. 회사 현황
- 02. 성장 연혁
- 03. 사업장 현황
- 04. 사업영역
- 05. 제품소개
- 06. R&D현황
- 07. 재무성과 (1),(2)



01 회사 현황



일반 현황

회사명	(주) 태성	
대표이사	김종학 (金鍾學)	
설립일	2006년 6월 법인설립 (2000년 8월 태성엔지니어링 창업)	
자산/ 자본	598억원 / 318억원 (2022년 6월 기준)	
자본금	24.1억원	
주요사업	PCB 자동화 설비 개발/ 제조/ 판매	
사업장	한국 본사	경기도 안산시 단원구 해안로 228
		종업원수: 120명
	해외 법인	동관태성기계유한공사 (중국 광둥성 동관시)
		태성아시아 (베트남 하노이 빈푹성)
R&D	총 27명: 부설연구소 5명, 설계/시스템개발 22명	

※ 2021년 12월 기준

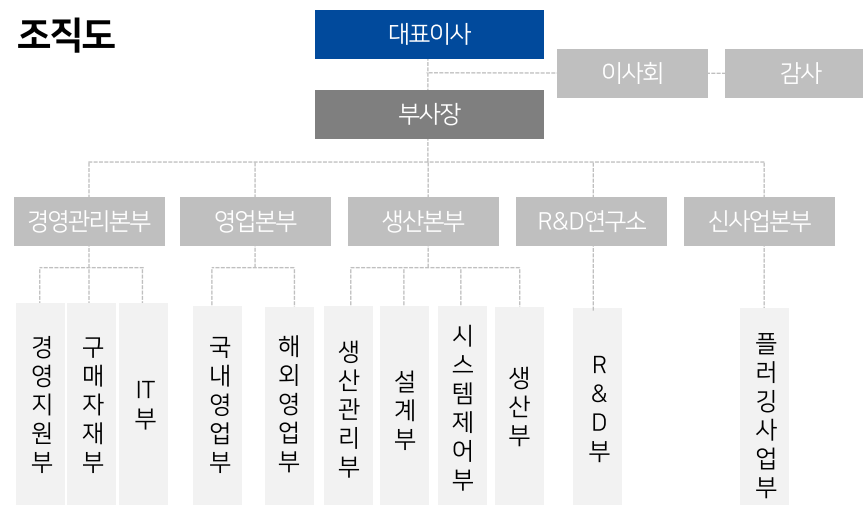
CEO Profile



김 종 학 대표이사

- 일진그룹 엔지니어
- 에덴기계 공장장
- 태성엔지니어링 대표
- 現 (주)태성 대표이사

조직도



02 성장 연혁



내수 중심에서 수출 중심 글로벌 기업으로 도약

1. 창립기

2000년~2005년



"PCB설비 국산화 선도"

- (00) 태성엔지니어링 창업
- (01) PCB 정면기, 동분여과기 개발
- (03) 중국 수출 개시/ Foxconn 社
중국 상하이 대리점 설립
- (04) FPCB 정면기 개발 및 상용화
- (05) 전자신문주간 올해의 히트상품
중국 수출 본격화/ZDT 外

2. 기반조성기

2006년~2010년



"제품라인 확대"

- (06) (주)태성 법인설립 (2.5억)
- (08) 박판형 JET SCRUBBER 개발
PCB 습식 설비 생산 출하 개시
- (09) 세라믹브러시 해외 수출-중국/대만
일본 수출 개시/메이코 社
일본 수출 본격화/이비덴 社
- (10) 정면기 부문 → 세계일류상품 선정
무역수출 100만불탑 수상

01

02

04

03

4. 도약기

2015년~2022년



"해외 거점 확보로 성장 본격화"

- (15) 동관태성(중국) 법인 설립
- (18) 태성아시아(베트남) 법인 설립
- (20) 소재·부품·설비 전문기업인증
- (22) 코스닥 상장 (SPAC 합병)

3. 성장기

2011년~2015년



"해외수출 확대"

- (11) 무역수출 300만불탑 수상
- (13) 무역수출 500만불탑 수상
- (14) 진공 이류체 D.E.S 양산
- (15) 무역수출 1,000만불탑 수상
대통령 산업포장 수상

03 사업장 현황



한국 및 중국 생산인프라 시너지 기반 글로벌 시장 적극 진출 교두보 마련

국내사업장



한국 본사	주식회사 태성
소재지	경기도 안산시 단원구 해안로 228
규 모	대지 2,000평 (6,598㎡) 연면적 4,124평 (13,631㎡) 증축 중 604평 (1,996㎡)
생산품목	PCB 정면기, WET 설비
임직원수	120명
생산전략	고부가가치 제품개발 Premium급 설비 양산
기타사항	*동관태성기계유한공사(지분 51%) *태성아시아(지분 100%)

해외사업장



중국 법인	동관태성기계유한공사
소재지	중국 광둥성 동관시 남주촌공업구
생산품목	PCB 정면기, WET 설비



베트남 법인	태성아시아 (판매법인)
소재지	Nguyen Tat Thanh Street, Tich Son Ward, Vinh Yen city, Vinh Phuc Province

04 사업영역

핵심기술 간 융합으로 다양한 산업에 적용 가능한 PCB 제조 공정 자동화 설비 개발

사업영역



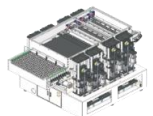
05 제품소개

세계 최고 수준의 품질 및 기술 경쟁력을 갖춘 다양한 제품 LINE UP



 : 주력제품군

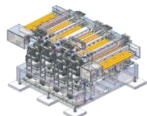
정면기 주요 경쟁사 대비 박판 대응 능력 우수한 다양한 제품군의 정면기 생산



0.05T 플렉시블



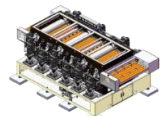
0.06T 초박판



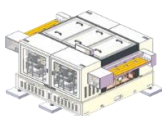
고다층 Rigid



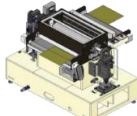
0.084T 박판



SUS 정면기



Rigid 일반형



Rigid 1축 정면기



동분여과기



9축 멀티플 정면기



4축 정면기(수세/건조단 포함)

기타 세라믹 브러시 제조/판매(PKG 기판 전용) 등



세라믹 브러시

국내 유일한
#2,000이상 급
세라믹 브러시 제조

PKG 기판 신규 공법 투자 및 FC-BGA
투자로 인한 HPP 연마기 및 세라믹
브러시 수요 증가

표면처리설비 20여종 이상의 다양한 공정의 표면처리 설비 제작



SR 전처리 Line



Pre Flux Line



PCB 습식 Line



박판용 PCB 습식 Line



HALF Etching Line



DESMEAR Line



브라운옥사이드



DFR 전처리 Line



금도금 전처리 Line



JET Scrubber Line



Alkali Etching Line

식각설비



D.E.S Line

PCB용 식각설비 외
OLED 용 Metal
Mask, Lead Frame
등 제품군 확장

수직비접촉설비 등



수직비접촉설비



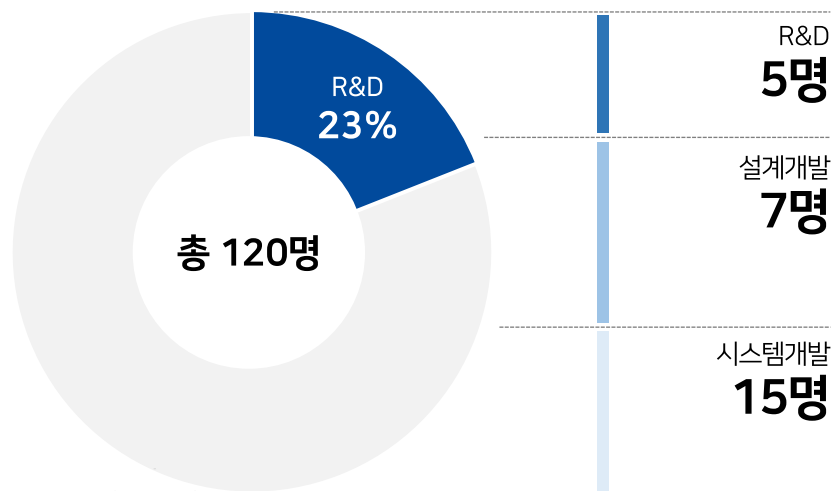
자동화설비

06 R&D현황

연구개발 인프라를 기반으로 지속적인 투자와 신제품 개발 집중



R&D 인력현황



**파트별 총 27명의
연구개발 전문인력 보유**
(기술연구소 외 시스템개발 인력 포함)

특허 등록 / 출원 현황

특허 등록 현황	
1	기판이송장치
2	매칭액 공급구조체
3	인쇄회로기판의예칭방법및 예칭장치
4	인쇄회로기판의습식예칭 공정에서 기판위의 퍼들링 제거를 위한 흡입 롤러 장치
...	
20	현상액배출 기능을 갖는 기판 현상장치
21	인쇄회로기판용 지그
22	인쇄회로기판제조용 가이드장치

국내외 특허 등록 22건 / 특허 출원 3건

국책과제 수행 현황

연구과제명	
1	PCB정면처리용 초박판정면기 개발 (기술혁신개발사업)
2	진공 및 이류체 적용한 초미세회로 PCB용 Subtractive Wet Etch System 개발 (수출기업개발사업)
3	PCB 0.06t 이하제품 생산을 위한 Sheet/ Roll to Roll 정면 System 개발 (수출기업개발사업)
4	광폭, 박판의 FPCB 롤투롤 수평 전해도 Pattern Plating System 개발 (수출기업개발사업)

국책과제 수행 4건 (24.9억원 지원)

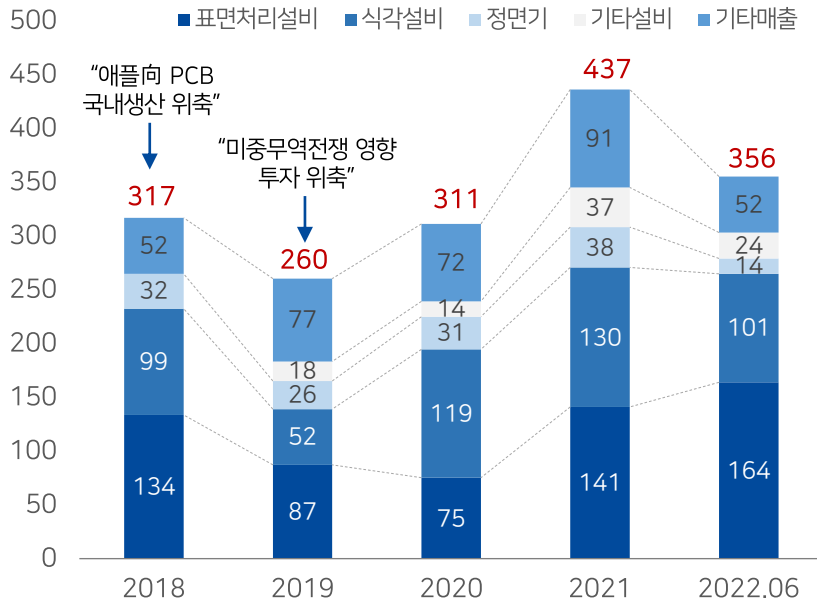
07 재무성과_(1) 경영실적



고부가가치 신규설비 수주 확대로 실적 Turn-around, 성장세 지속

제품별 매출

(단위: 억원)

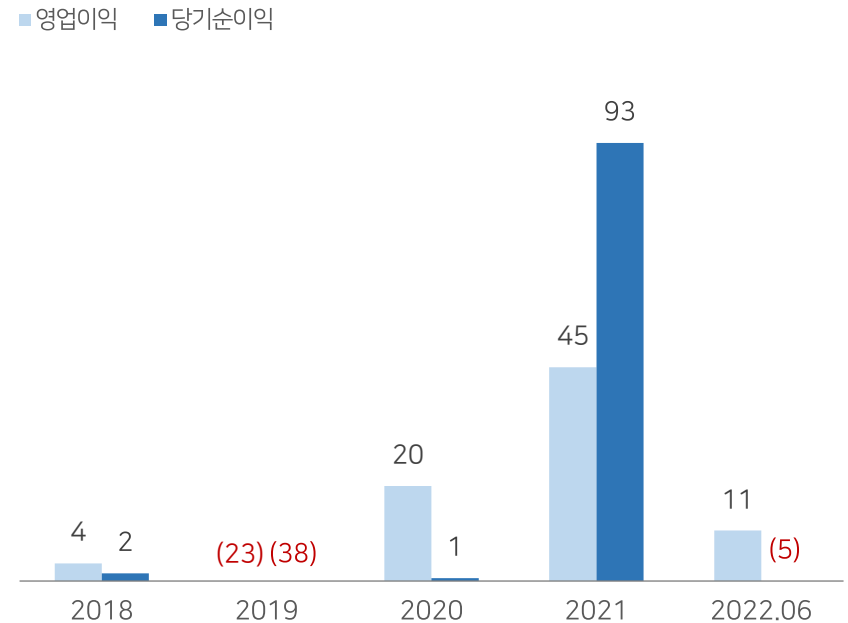


※ 별도재무제표 기준

- 글로벌 Maker들의 FPCB 수요 증가로 고부가가치 신규 설비 D.E.S Line 매출 확대
- PKG기판신규공법 & FC-BGA 투자 확대 → HPP 연마기 및 세라믹 브러시 수요 증가
- C/S 수요 지속발생으로 유지/보수 매출 증가 → 오랜 업력 기반 매출 안정성 향상

영업이익 및 당기순이익

(단위: 억원)



※ 별도재무제표 기준

- 2019년 초도매출을 위한 저가 수주 및 K-IFRS 전환에 따른 손익 조정
- 고부가가치 제품 매출 확대에 의한 수익성개선 지속
- 2020/2021년 RCPS 평가 손익 반영에 따라 당기순이익은 과소, 과대 계상
- 2022년 합병비용 28억 반영

07 재무성과_(2) 안정적인 매출 구조

다수의 매출처 확보를 통해 수주기반 안정적 매출 확보

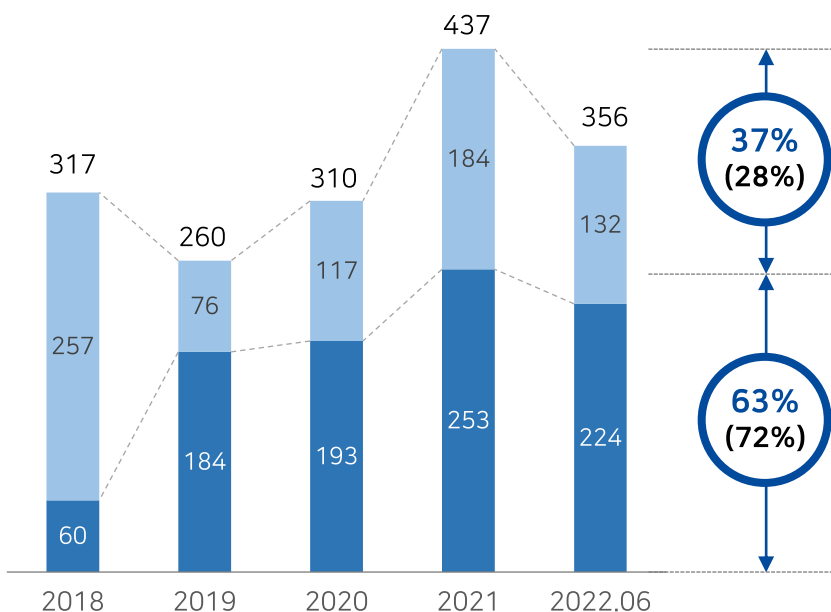


국내 / 해외매출

(단위: %)

■ 해외매출 ■ 국내매출

“해외 구매선 확대로
Turn-around 기반 마련”



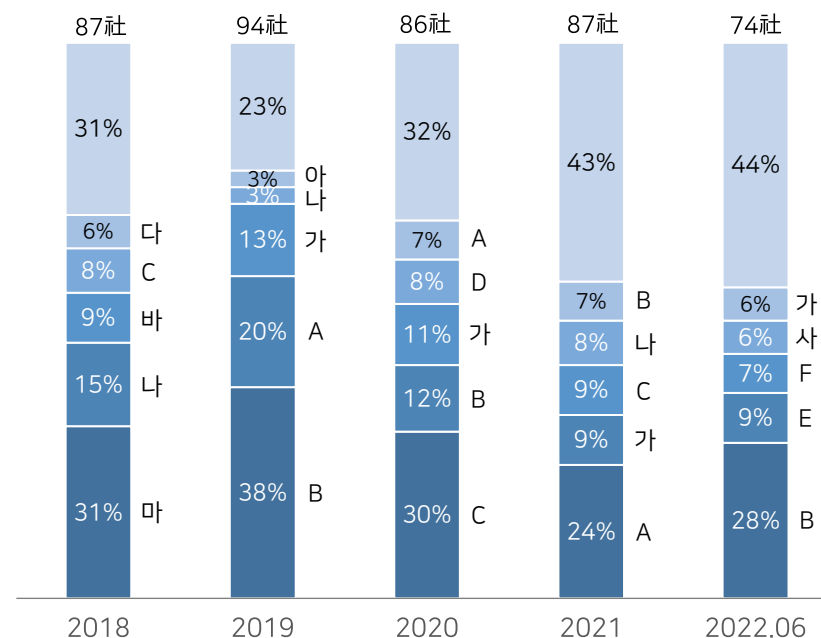
※ 별도재무제표 기준, (%)는 제품매출 기준

고객사별 매출 비중

(단위: %)

■ 1위 ■ 2위 ■ 3위 ■ 4위 ■ 5위 ■ 기타

“다양한 매출처 확보를 통해
매출 안정성 강화”

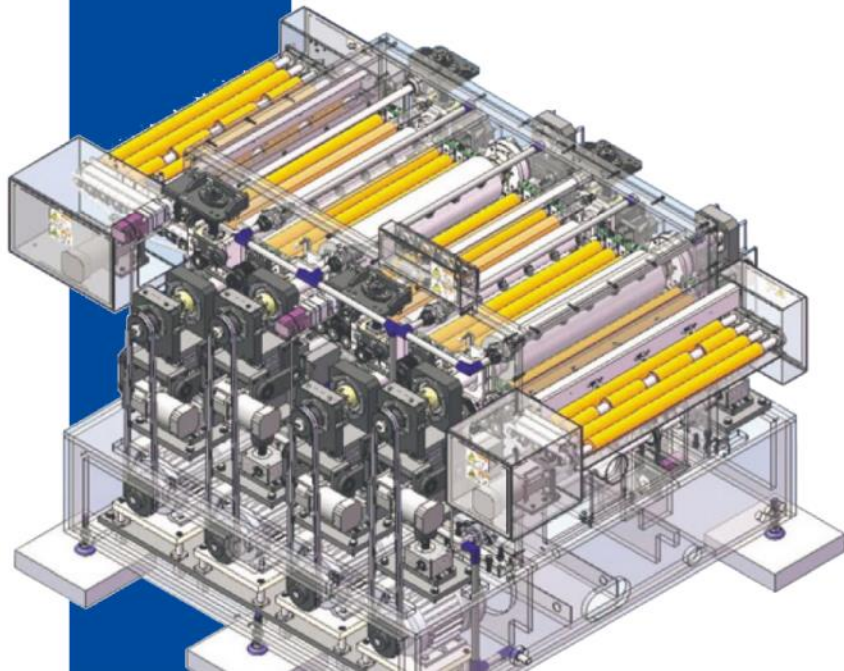


※ 별도재무제표 기준

2. Market Sketch

01. 전방산업 동향 (1)

02. 전방산업 동향 (2)



01 전방산업 동향 (1)

반도체, 전자부품, 통신(5G) 등 4차산업을 필두로 아시아지역이 PCB 생산의 메카

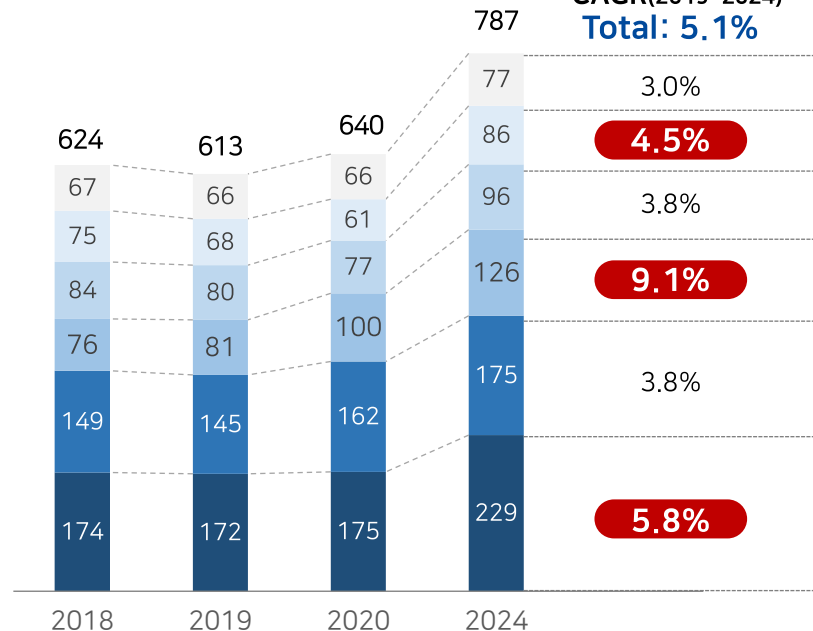
PCB 분야별 시장전망

(단위: 억\$)

PCB 산업은 통신, 전자, 반도체 패키지 분야를 중심으로 고성장세 시현

■ 통신 ■ 컴퓨팅 ■ 반도체패키지 ■ 가전 ■ 전자 ■ 기타

CAGR(2019~2024)
Total: 5.1%

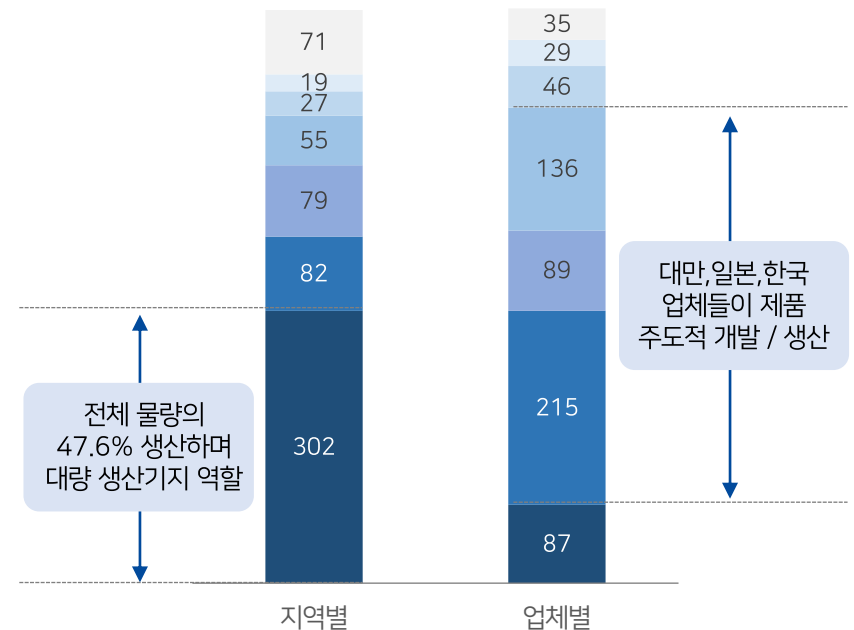


※ 출처: Primark

PCB 생산 현황 (지역별 / 업체별)

(단위: 억\$)

■ 중국 ■ 대만 ■ 한국 ■ 일본 ■ 미국 ■ 유럽 ■ 기타



※ 출처: WECC, CPCA, IPC, JPCA, TPCA, HKPCA

02 전방산업 동향 (2)

국내 / 중국 PCB 산업 현황

국내 주요 PCB 업체 투자 계획

SAMSUNG

삼성전기

국내업체 중 FC-BGA점유율 1위로
1.4조 원 규모 증설 투자 예정

LG 이노텍

FC-BGA의 수요 증가에 따라 신규사업 진출 결정
1조 원 규모 시설투자 예정

DAEDUCK

FC-BGA 신공장 생산라인 증축을 위해
4,000억원 투자 예정

중국 PCB 산업 현황



PCB제조업체 매출
상위 50개 중 중국업체 27개



50% 육박하는
세계시장 점유율

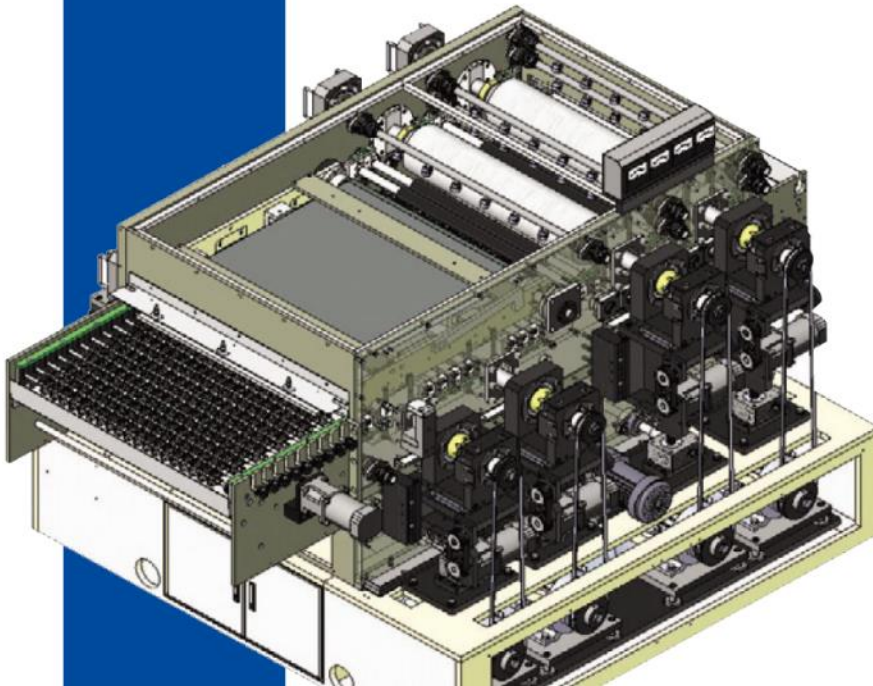


막강한 내수시장

고사양 PCB에 대한 수요 증가로
생산 공정 고도화 니즈 증대

3. Investment Highlights

- 01. PCB 공정 자동화 부문 Unique Total Provider
- 02. PCB 공정 자동화 설비 매출 1위
- 03. 업계 최고 R&D 역량 보유
- 04. 국내외 Top tier 공급 레퍼런스 확보
- 05. 수주증대로 성장기조 유효



01 PCB 공정 자동화 부문 Unique Total Provider



PCB 제조 장치 산업내 필수설비 제조

PCB 생산 공정내 역할

● : 당사 공급 ● : 미공급

“ PCB 생산 공정 전반에 걸친 제조 자동화설비 개발/공급 ”



국내 최초 정면기 개발로
생산 수율 개선 및 초정밀도 향상
→ 세계일류상품 선정



IMAGE 핵심공정인
D.E.S Line
세계 최고 기술력 보유



전, 후공정 완전 자동화 선도
수동·반자동화
→ 완전 자동화 공정설비로 대체

02 PCB 공정 자동화 설비 매출 1위



기술 경쟁력 기반 공정 자동화 설비 시장 점유율 확대 지속

공정 자동화 설비 개발 스토리



세계 초일류 상품으로 PCB 공정 자동화 설비 국산화 선도

- PCB 前처리 공정 부문 선도
→ 공정 자동화 설비 국내시장점유율 1위
- 다양한 PCB 핵심자동화 설비 Line Up 확보

세계 최고품질의 D.E.S Line 설비

- PCB공정자동화설비부문 확고한시장 지배력보유
→ Lock in 효과를 통한 시장 점유 확대
- 세계 1위의 기술경쟁력 보유

Turn-key Solution 구축

- 고객수요에 맞춘 Turn-Key Solution 구축
- 축적된 핵심기술 Know-how 기술경쟁력 기반 차세대 융복합 설비 개발 지속

VS

후공정 검사설비 등에 주로 적용

상대적으로 低난이도
PCB 후공정 설비에 주로 납품

경쟁사 현황

특정 라인의 단품 설비 위주 공급

기술력 격차로 인한
프리미엄 설비 시장 진입 난항

03 업계 최고 R&D 역량 보유



20년 업력의 베테랑 기술진의 기술력을 바탕으로 선행기술 개발

구성원 현황

"기계산업 전문업력 40년" 김 종 학 (金鍾學) 대표이사 	전무 박 철 원 "설비·제조 전문업력 28년" • 한양사이버대학교 기계공학과 • (주)삼성전기 • 영풍그룹(인터플렉스,, 코리아씨키트) 	상무 / CMO 박 경 택 "설비·제조 전문업력 22년" • 성균관대학교 화학공학과 • (주) LG이노텍 • 콘티넨탈오토모티브&비테스코 	이사 김 상 길 "설비·제조 전문업력 21년" • 명지대학교 기계공학과 • (주)세메스 • (주)에스엠에이 대표 
	이사 이 석 환 "설비·제조 전문업력 18년" • 경희대학교 원자력공학과 • 산영전기(주) 	연구소장 권 민 준 "PCB설비연구개발 16년" • 인천대 토목공학과 • (주)우리엔지니어링 이사 	설계리더 문 경 재 "PCB설비 설계업력 18년" • 광주인력개발원 전산과 • (주)케이씨텍 • (주)에스엠씨 • 유니테크놀로지(주) 

R&D 역량

 22년 설비 생산기술 노하우	 SW + HW 전문 연구인력 구성 - 경력10년 이상 : 30명 - 설계 : 7명 - 시스템제어 : 15명	 세계 최고수준의 일류상품 개발 - 진공·이류체 D.E.S 라인 - RTR 수평도금 라인 - 비접촉 수직현상 라인 - RTR/SHT 겸용 초박판 정면 라인
---	---	--

04 국내외 Top tier 공급 레퍼런스 확보



우수한 제품 바탕의 국내외 50여개 고객사 포트폴리오 확보

Lenovo

SAMSUNG 삼성전기 **LG이노텍** **DAEDUCK** **Korea Circuit**

글로벌 Big Maker에 PCB 생산 설비 공급
글로벌 PCB시장 30위권 업체 매출 비중 70~80% 유지

중국10대기업 공급

臻鼎科技 Zhen Ding Tech. 평딩	兴森科技 FASTPRINT Fast Print(흥삼사)	SCC 深南电路 SCC(선난써킷트)
--------------------------------------	---	-------------------------------

국내 고객사



해외 고객사

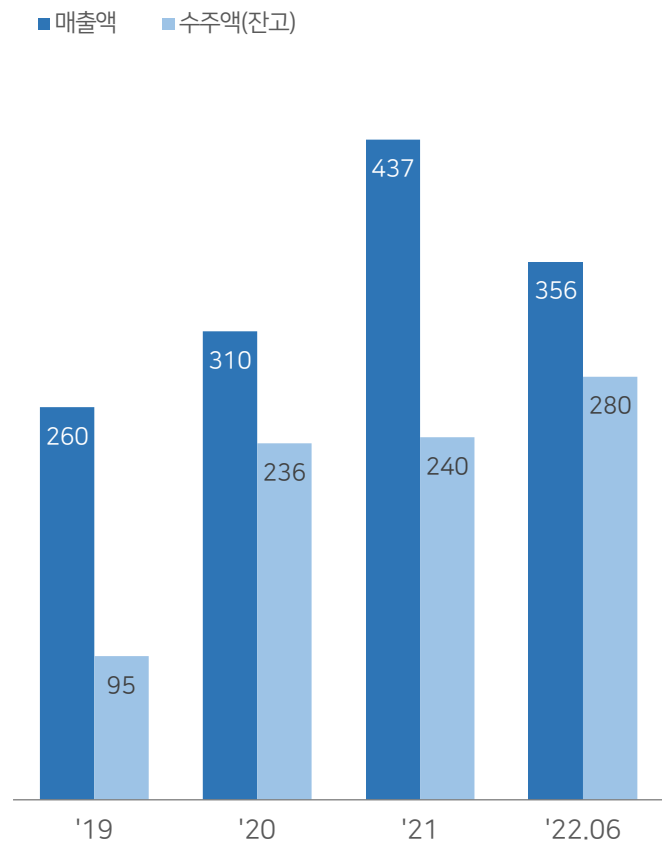


05 수주증대로 성장기조 유효

반기 매출대비 79% 이상 총 280억원 규모 수주 기 확보

매출액 / 수주잔고 추이

(단위: 억원)



※ 출처: 합병신고서 별도재무제표 기준

수주잔고 확대 요인

01 고객사 설비 투자 증가

- 중국 및 국내 대규모 공장증설에 따른 투자 증가, 반도체 패키지 투자 2~3년간 지속 전망

02 프리미엄급 설비 수주 확대

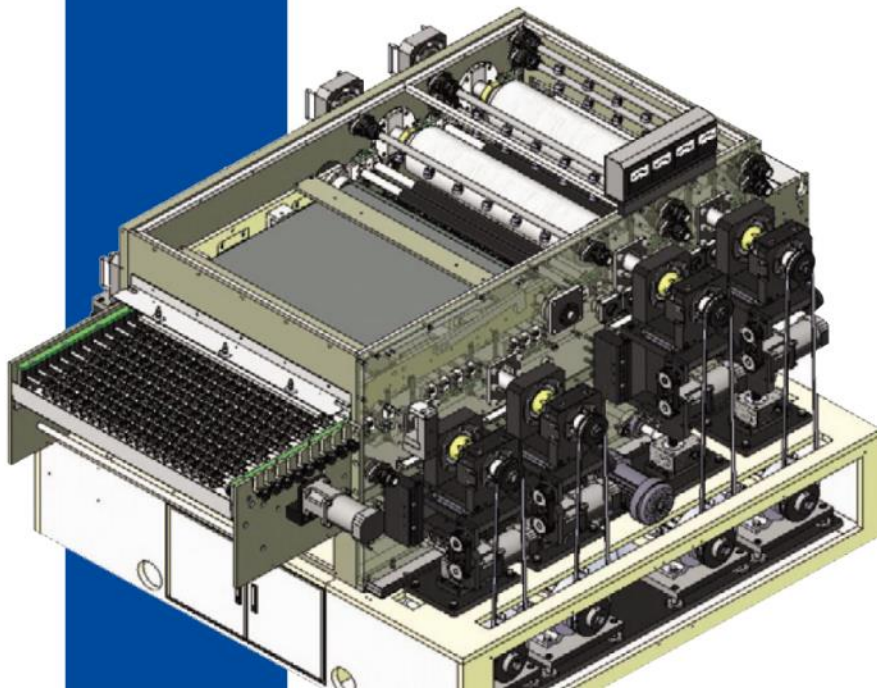
- FC-BGA 투자 증가하며 프리미엄 설비 공급 확대에 따른 제품 평균단가 증가

03 고객사별 수주규모 확대

- 프리미엄급 설비의 경우 안정성 담보를 위해 단품보다 Turn-key 공급 비중 확대

4. Growth Strategy

- 01. 글로벌 Player 위상 강화
- 02. 고부가가치 제품 확대
- 03. 명실상부한 종합 PCB 제조설비 Maker로 자리매김
- 04. Vision



01 글로벌 Player 위상 강화

중국 및 베트남 법인 구축으로 글로벌 시장 공략 가속화

"PCB 생산량의 80%가 중국과 동남아시아에 집중"



아시아지역 비중 확대



해외 수출 확대 및 전략적 마케팅

대만 시장 확대

- FPCB 설비 신규 진입 및 생산량 증가
- 세계 PCB 상위 기업 포진에 따른 공략

→ 평딩(Foxconn 자회사) 진입 및 공급 확대

중국 시장 확대

- 중국 내 다국적 PCB 생산기지 확대
- 반도체용 PKG 설비 신규 진입 확대

→ 동관태성기계 유한공사(중국)의 영업 및 제조인력의 충원을 통한 설비제작 가동률 제고

동남아시아 시장 확대

- 베트남, 동남아 제1의 PCB 생산국 안착
- 말레이시아, 동남아 제2의 PCB 생산국 급부상

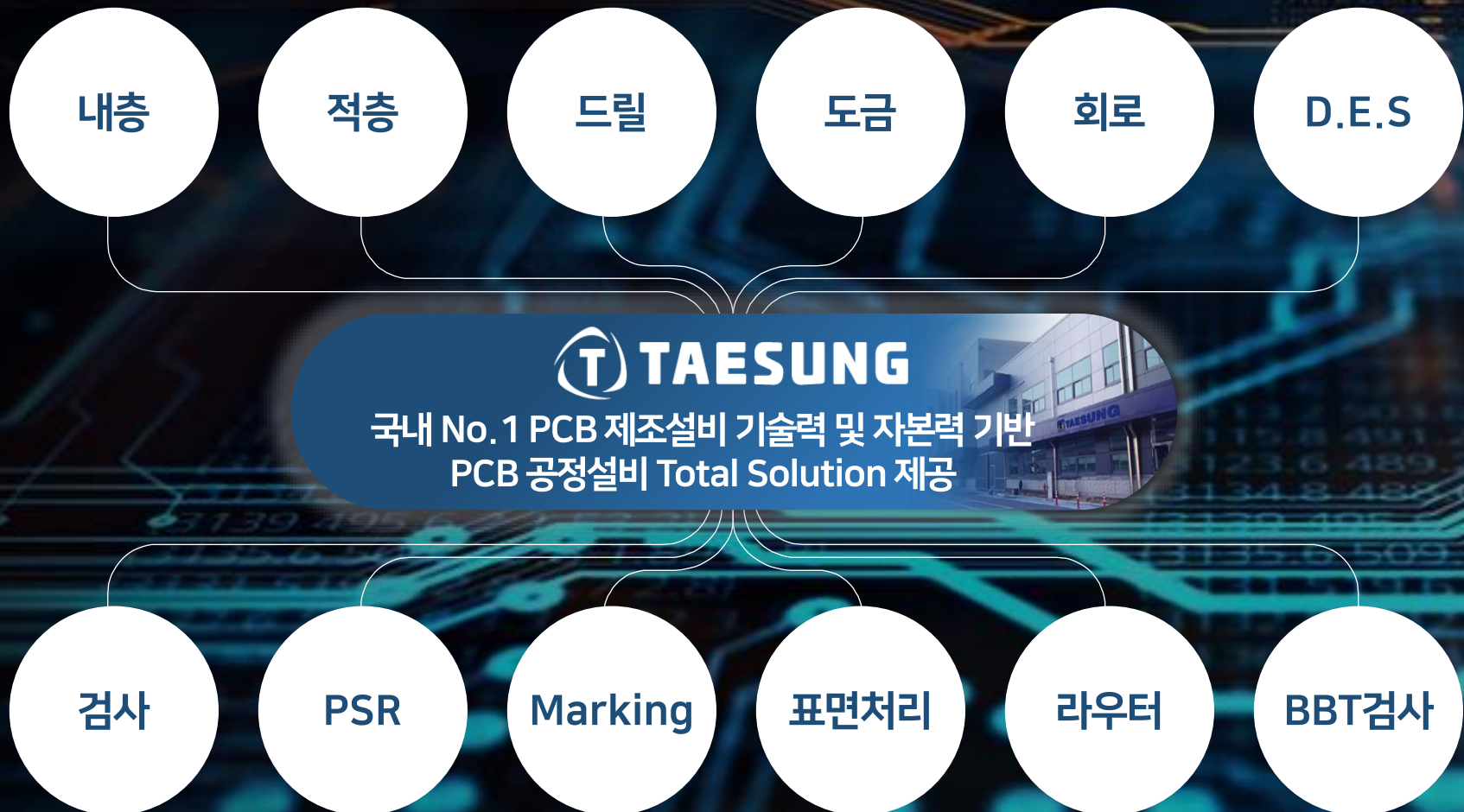
→ 태성아시아(베트남)를 통해 동남아시아 시장 공략 및 향후 수요발생시 제조공장 운영

02 고부가가치 제품 확대

응용제품 및 융복합설비 개발을 통한 시장 대체 및 매출 성장 달성



03 명실상부한 종합 PCB 제조설비 Maker로 자리매김



04 Vision

“PCB자동화 설비 국내 1위를 넘어, **세계 일류로 도약하는 기업**”



한국 본사와 중국, 베트남 법인과의 Collaboration을 통한 글로벌 매출 확대로
2025년 매출 1,000억 원 목표

응용제품
확대

글로벌 매출
확대

신성장 동력
확보

핵심 역량

01

차별화된
제품경쟁력

02

축적된 설비개발
Know-How
핵심 원천기술 보유

03

높은 수익성
건실한 재무구조

04

안정적인 매출구조
우량고객 저변확대

Appendix

01. 요약 연결재무제표

02. 합병에 관한 사항



01 요약 연결재무제표

요약 연결재무상태표

(단위: 백만원)

구분	2019	2020	2021	2022.06
유동자산	15,417	18,734	28,891	38,246
비유동자산	22,168	22,075	20,889	21,510
자산총계	37,584	40,809	49,779	59,756
유동부채	33,172	37,541	28,156	26,240
비유동부채	3,011	694	639	1,745
부채총계	36,183	38,235	28,795	27,985
자본금	1,853	1,853	2,886	2,414
자본잉여금	2,764	2,764	10,809	22,242
기타포괄손익누계 등	19	1,130	1,211	1,495
이익잉여금	(3,235)	(3,172)	6,079	5,620
자본총계	1,401	2,574	20,985	31,771

※ 별도재무제표 기준

요약 연결손익계산서

(단위: 백만원)

구분	2019	2020	2021	2022.06
매출액	26,084	31,434	43,940	35,562
매출원가	25,657	25,604	34,483	29,988
매출총이익	427	5,830	9,457	5,574
판매비와 관리비	2,769	3,635	4,832	4,508
영업이익	(2,341)	2,195	4,625	1,066
영업외수익	507	567	7,347	1,892
영업외비용	2,089	2,519	1,810	3,241
법인세비용 차감 전 순이익	(4,059)	(216)	10,172	(283)
법인세비용	(195)	153	922	181
당기순이익	(3,864)	63	9,251	(464)

※ 별도재무제표 기준

02 합병에 관한 사항

합병 전후 지분(율) 변동 및 보호예수 현황

(2022년 6월 15일 기준)

성명	구분	합병 전				합병 후		합병 후 (CB전환 후)		보호예수기간
		태성		신영스팩 5호		태성		태성		
		주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)	
최대주주등		2,968,541	51.43%	-	-	10,612,533	43.96%	10,612,533	42.06%	합병상장일로부터 1년 6개월
YOUNGROUP ELECTRONIC		387,445	6.71%	-	-	1,385,115	5.74%	1,385,115	5.49%	합병상장일로부터 3개월
한국산업은행 등 (10개사)		2,066,666	35.77%	-	-	7,388,330	30.59%	7,388,330	29.27%	합병상장일로부터 1개월(50%)
우리사주조합	미등기임원	10,940	0.19%	-	-	39,109	0.16%	39,109	0.15%	합병상장일로부터 1년 6개월
	직원	189,060	3.28%	-	-	675,891	2.80%	675,891	2.68%	-
기타주주		150,000	2.60%	-	-	536,252	2.22%	536,252	2.12%	-
태성 소계		5,772,652	100.00%	-	-	20,637,230	85.48%	20,637,230	81.77%	-
에이벤처스(주)	발기주주	-	-	100,000	2.85%	100,000	0.41%	100,000	0.40%	합병상장일로부터 6개월
신영증권(주)	발기주주	-	-	5,000	0.14%	5,000	0.02%	1,100,000	4.36%	합병상장일로부터 6개월
기타공모주주		-	-	3,400,000	97.00%	3,400,000	14.08%	3,400,000	13.47%	-
신영스팩 5호 소계		-	-	3,505,000	100.00%	3,505,000	14.52%	4,600,000	18.23%	-
합계		5,772,652	100.00%	3,505,000	100.00%	24,142,230	100.00%	25,237,230	100.00%	-

※ 출처: 합병신고서 기준